

**Bruxelles, 25 august 2025
(OR. en)**

**14559/18
COR 1 (ro)**

**ENV 797
MI 870
DELECT 153**

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretara generală a Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, Director
Data primirii:	25 august 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2025) 5889 final
Subiect:	RECTIFICARE la Directiva delegată (UE) 2019/172 a Comisiei din 16 noiembrie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate de tip „flip chip” (<i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 5 februarie 2019</i>)

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2025) 5889 final.

Anexă: C(2025) 5889 final



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 22.8.2025
C(2025) 5889 final

RECTIFICARE

la Directiva delegată (UE) 2019/172 a Comisiei din 16 noiembrie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcusele de circuite integrate de tip „flip chip”

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 5 februarie 2019)

RECTIFICARE

la Directiva delegată (UE) 2019/172 a Comisiei din 16 noiembrie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcassele de circuite integrate de tip „flip chip”

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 5 februarie 2019)

La pagina 14, în titlu:

în loc de: „de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcassele de circuite integrate de tip «flip chip»”,

se citește: „de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcassele de circuite integrate de tip «flip chip»”.

La pagina 14, la considerentul (3) a doua teză:

în loc de: „Utilizarea plumbului în sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului”,

se citește: „Utilizarea plumbului în aliajele de lipit pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului”.

La pagina 14, la considerentul (5), prima și a doua teză:

în loc de: „Sudurile cu plumb sunt utilizate la conexiunile de tip «flip chip» sub formă de suduri convexe (*bumps*) și suduri pentru fixarea cipului pe substratul său. Sudurile trebuie să fie rezistente la defectele cauzate de electromigrarea ce are loc la densitățile necesare ale curentului, care sunt extrem de înalte, și să poată crea o ierarhie a sudurilor care permite asamblarea în etape și recondiționarea componentelor în procesul de fabricație.”,

se citește: „Aliajele de lipit cu plumb sunt utilizate la conexiunile de tip «flip chip» sub formă de suduri convexe (*bumps*) și aliaje de lipit pentru fixarea cipului pe substratul său. Aliajele de lipit trebuie să fie rezistente la defectele cauzate de electromigrarea ce are loc la densitățile necesare ale curentului, care sunt extrem de înalte, și să poată crea o ierarhie a aliajelor de lipit care permite asamblarea în etape și recondiționarea componentelor în procesul de fabricație.”.

La pagina 16, în anexa care înlocuiește punctul 15 din anexa III la Directiva 2011/65/UE, în tabel, punctul 15 a doua coloană:

în loc de: „Plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcusele de circuite integrate de tip «flip chip»”,

se citește: „Plumbul din aliajele de lipit pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcusele de circuite integrate de tip «flip chip»”.

La pagina 16, în anexa care înlocuiește punctul 15 din anexa III la Directiva 2011/65/UE, în tabel, noul punct 15(a) a doua coloană, teza introductivă:

în loc de: „Plumbul din sudurile pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcusele de circuite integrate de tip «flip chip», dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele criterii:”,

se citește: „Plumbul din aliajele de lipit pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcusele de circuite integrate de tip «flip chip», dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele criterii:”.